

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

오디텍(080520)

반도체/반도체장비

요약

기업현황

시장동향

기술분석

재무분석

주요 변동사항 및 전망



작성기관

한국기업데이터(주)

작성자

구완서 전문위원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3215-2398)으로 연락하여 주시기 바랍니다.



한국IR협회

오디텍(080520)

반도체 기술 및 센서 기술을 활용한 Total Solution을 제공하는 센서 전문기업

기업정보(2021/01/18 기준)

대표자	박병근
설립일자	1999년 12월 06일
상장일자	2007년 10월 08일
기업규모	중소기업
업종분류	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 레이저 프린터용 COB, Zener 다이오드 칩, 포토다이오드 등
주요제품	

■ 회사 연혁 및 주요 사업 분야

주식회사 오디텍은 반도체 개발 제조업 및 패키징 사업, 센서 소자 제조 등을 영위할 목적으로 1999년 12월에 설립되었으며, 반도체 제조 공정(FAB)을 바탕으로 비메모리 반도체 칩과 센서 및 센서 모듈, 시스템의 수직계열화된 제품을 생산하고 있으며, 추가로 LED 응용제품을 생산하고 있다.

5인치 Silicon Fabrication(광반도체 칩 제조)을 갖추고 고객의 요구에 따라 다양한 형태의 비메모리 반도체를 개발, 설계하여 제품을 공급하고 있으며 레이저 프린터용 COB, Zener 다이오드 칩을 중심으로 포토다이오드, Power Transistor 칩 등을 제조 및 판매하고 있다.

또한, 개발된 광반도체 칩을 시장의 요구에 맞는 패키지로 설계, 개발하여 시장을 개척하고 있으며, 축적된 노하우와 기술 인력을 활용하여 다양한 광반도체를 판매하고 있다. 특히 광센서 모듈의 개발까지 병행함으로써 칩과 개별회로(Discrete) 제조 및 판매에 그치지 않고 개별회로 소자를 모듈화하여 센서 시장을 확대하는 전략을 펼치고 있다.

■ 비전 및 미션

주식회사 오디텍은 지속적인 연구개발투자를 통해 반도체 기술 및 센서 기술 향상하고 이를 활용하여 고부가가치의 신제품을 개발하는 등 제품경쟁력을 기반으로 글로벌 시장을 개척할 계획으로 2025년까지 3,000억 원의 매출을 달성하기 위한 비전을 제시하고 있다.

또한, 세부적인 미션으로 센서 부문의 경우, 다양한 고객과 경쟁력 있는 제품을 개발하여 매출 1,000억 달성과 센서 기반 기술/신기술 확보를 통한 글로벌 시장 개척을 목표로 하고 있다. 반도체 부문의 경우, Zener 다이오드 시장 점유율 국내 1위, 중국 시장 성공적 진입, 전력반도체 생산 세계 5위 달성을 통한 매출 2,000억 달성을 목표로 하고 있다.

시세정보(2021/01/25 기준)

현재가(원)	5,950
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	700
발행주식수(주)	11,746,609
52주 최고가(원)	6,200
52주 최저가(원)	2,235
외국인지분율	4.40%
주요주주	박병근

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2017	489.8	-12.09	42.7	8.72	39.6	8.09	3.45	3.20	6.89	337	10,227	25.04	0.83
2018	452.3	-7.67	10.9	2.42	34.6	7.65	2.98	2.80	6.33	295	10,563	19.97	0.56
2019	416.5	-7.91	12.0	2.88	21.4	5.13	1.82	1.71	5.94	182	10,534	26.75	0.46

기업경쟁력

기술경영

- 특허권, 상표권 등 다수 지식재산권 보유
- 선제적 품질관리를 통한 양산 품질 안정화 구현
 - 전사적 품질경영 활동을 통한 고객 만족도 향상

인증 및 수상실적

- 연구개발특구 첨단기술기업 인증(교육과학기술부)
- 벤처 활성화 유공포상(국무총리)
- 희망 이음 프로젝트 공로상 수상(산업통상자원부)

핵심기술 및 적용제품

핵심기술

- 연구개발실적을 통해 확보한 기술
 - X-Ray용 포토 칩 Array 개발
 - Sub-Mount 일체형 포토 칩 개발
 - UV 센싱용 포토 칩 개발
 - IrDA용 포토다이오드 칩 개발
 - Color 센서용 포토다이오드 칩 개발
 - 범용 포토다이오드 칩 개발
 - ESD 방지용 Zener 다이오드 칩 개발
 - 조명용 LED Sub-Mount 칩 개발
 - 레이저 프린터용 포토다이오드 개발

적용제품

- Zener 다이오드
- Sub-Mount
- Power Transistor
- 초소형 광전 센서



제품별 매출 비중(2020년 3분기) (단위: 백만 원)

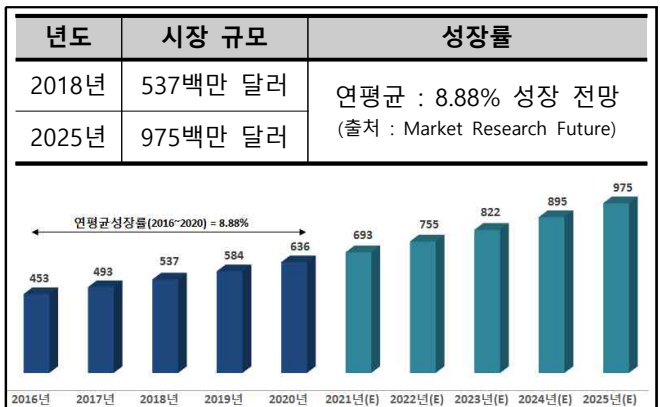
매출형태		매출액	비중(%)
제품	반도체 칩	11,255	36.29
	레이저 프린트용 COB	7,556	24.36
	기타(소자 등)	7,340	23.67
상품	소자	772	2.49
종속회사	반도체 칩	4,089	13.19
합계		31,012	100.00

시장경쟁력

기술역량

- 높은 품질의 광반도체 및 센서 제품개발/공급
- 꾸준한 연구개발을 통해 기술 고도화
- 경쟁사 대비 경쟁력
 - KICOX 글로벌 선도기업(한국산업단지공단)
 - 세계로 가는 전북기업 선정(전라북도청)

세계 광센서 시장 규모



최근 변동사항

사업 다각화 및 신제품 개발

- 신규 추진 사업계획
 - (센서 부문)
 - ▶ 고신뢰도/고부가가치의 자동차 전장용 광센서 부품
 - ▶ 방산용 센서
 - ▶ 센서 패키지 사업
 - ▶ 바이오 헬스케어(바이오센서) 사업
 - (반도체 부문)
 - ▶ 플립칩(Flip chip) 패키지에 적용할 수 있는 증착 방식과 식각 기술활용 : 고부가가치 제품개발 사업

I. 기업현황

광센서 관련된 Total Solution을 제공하는 센서 전문기업

동사는 1999년 12월 설립되었고, 레이저 프린터용 COB(Chip On Board) 등의 센서 제품과 Zener 다이오드 칩, 포토다이오드 등의 반도체 소자 제품을 제조하고 있다.

■ 회사 연혁 및 주요 사업 분야

주식회사 오디텍(이하 ‘동사’)은 반도체 개발 제조업 및 패키징 사업, 센서 소자 제조 등을 영위할 목적으로 1999년 12월에 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥에 상장되었고, 2019년 말 기준 총자산 124,507백만 원, 자기자본 117,527백만 원(납입자본금 5,873백만 원) 규모의 중소기업이며, 2020년 9월 30일 기준 228명의 직원이 근무하고 있다.

동사는 반도체 제조 공정(FAB)을 바탕으로 비메모리 반도체 칩과 센서 및 센서 모듈, 시스템의 수직계열화된 제품을 생산하고 있으며, 추가로 LED 응용제품을 생산하고 있다. 동사는 작성일 기준 1개의 종속회사를 보유하고 있으며, 종속회사인 오디텍 반도체(남경)유한공사는 매출 유형 중 반도체 부문에 속하는 비메모리 반도체 칩을 생산하고 있다.

동사 및 종속회사는 비메모리 반도체를 생산하는 단일 사업 부문이나, 수익을 창출하는 재화 용역 성격, 이익 창출 단위, 제품 및 제조공정 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영다각화 실패를 반영하기 위해 매출 유형별로 센서 부문 및 반도체 부문으로 세분화하였다.

[표 1] 동사 및 종속회사의 매출 유형별 현황

구분	회사	주요 재화 및 용역	주요고객	사업의 내용
센서 부문	동사	광소자, 광센서, 센서 Package, 센서 모듈, LED 응용 외	현대 엘리베이터 외 170개 업체	광센서, Area 센서, 도로교통시스템(ETCS), LED 식물공장, 광 응용제품 등
반도체 부문	동사	비메모리 반도체 Chip 제조	삼성전자 외 70개 업체	일반 반도체, 전력반도체, 광반도체 제품 생산
	종속회사		Powin 외 10개 업체	전력반도체, 광반도체 생산

*출처 : 동사 분기 보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

동사는 5인치 Silicon Fabrication(광반도체 칩 제조)을 갖추고 고객의 요구에 따라 다양한 형태의 비메모리 반도체를 개발, 설계하여 제품을 공급하고 있으며, Zener 다이오드 칩을 중심으로 포토다이오드, Power Transistor 칩 등을 제조 및 판매하고 있다.

또한, 개발된 광반도체 칩을 시장의 요구에 맞는 패키지로 설계, 개발하여 시장을 개척하고 있으며, 축적된 노하우와 기술 인력을 활용하여 다양한 광반도체를 판매하고 있다. 동사는 광센서 모듈의 개발까지 병행함으로써 칩과 개별회로(Discrete) 제조 및 판매에 그치지 않고 개별회로 소자를 모듈화하여 센서 시장을 확대하는 전략을 펼치고 있다.

■ 대표이사 정보 및 경영진

대표이사 박병근(1962년생, 남)은 전북대학교 전기공학과를 졸업하였고, 한국고텐시(주)(1989년~1996년)에서 근무하고, 포토리서치(1996년~1999년, 최종직위 : 대표자)를 운영한 경험을 바탕으로 1999년 12월 대표이사에 취임하여 현재까지 경영 전반을 총괄하고 있다.

동인은 사업성이 좋은 핵심 아이템의 역량을 강화해 품질을 향상하고 판매가격을 현실화시키는 정책을 취하고 있다. 또한, 동인은 목표시장을 센서 시장 분야로 설정하고 주력 사업 분야에 대한 뚜렷한 목표관리 시스템을 구축하여 주요 업무 분야 전담 인력을 두고 기술경쟁력 확대를 위한 투자와 지원을 아끼지 않고 있으며, 기술 관련 다양한 인증 획득에 심혈을 기울이고 있고, 기술사업화 관련 각종 규제 및 정책 등에 대해 파악하고 있다.

[표 2] 주요 주주 구성

주요 주주	관계	주식(주)	지분율(%)
박병근	본인	1,502,427	12.79
이학수	임원	515,895	4.39
김강호	임원	478,264	4.07
최봉민	임원	478,978	4.08
계		2,975,564	25.33

*출처 : 동사 분기 보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 동사의 주요 제품

동사는 레이저 프린터용 COB(Chip On Board) 등의 센서 제품과 Zener 다이오드 칩, 포토다이오드 등의 반도체 소자 제품을 제조하고 있으며, 제품별 매출액 및 비율은 다음과 같다.

[표 3] 유형별 매출 비중

(단위 : 백만 원)

매출 유형 및 품목		2020년 3분기	비중(%)	2019년	2018년	
제품	반도체 칩	수출	6,888	36.29	10,227	10,647
		내수	4,367		6,801	6,112
		소계	11,255		17,028	16,759
	레이저 프린트용 COB	수출	2,844	24.36	3,668	4,675
		내수	4,712		5,666	5,837
		소계	7,556		9,333	10,513
	기타(소자 등)	수출	2,732	23.67	4,856	5,015
		내수	4,608		5,695	7,889
		소계	7,340		10,551	12,904
상품	소자	수출	403	2.49	338	411
		내수	369		482	880
		소계	772		820	1,291
종속 회사	반도체 칩	내수	4,089	13.19	3,917	3,759
수출		12,868	41.49	19,089	20,748	
내수		18,144	58.51	22,560	24,477	
합계		31,012	100.00	41,649	45,225	

*출처 : 동사 분기 보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

II. 시장 동향

지속적인 성장이 기대되는 센서 시장

센서 시장은 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등과 결합하여 스마트 공장, 로봇, 사물인터넷 등의 새로운 산업 플랫폼을 형성할 것으로 예상되는 등 지속적인 시장 확대가 기대된다.

■ 광반도체 시장 동향

반도체는 스마트폰, 컴퓨터 등 전자장치의 입출력 및 주요 기능을 수행하는 핵심 부품으로 입출력, 감지, 연산, 변환, 저장, 전달 등의 기능을 하는 것이다. 반도체는 정보를 저장하는 메모리와 전자기기를 제어/운용하는 시스템 반도체로 구분하고 있으며, 국내에서는 메모리 반도체 분야를 주로 생산하고 있고, 메모리가 아닌 반도체는 모두 시스템 반도체라고 부르고 있다.

동사 반도체 칩 제조부문 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 Zener 다이오드 칩과 Sub-Mount 칩 제품은 LED가 빛을 발할 때 나오는 정전기와 열을 방지시켜주는 역할을 하는 일종의 광반도체이며, LED 디스플레이 관련 산업과 밀접한 관계가 있다.

일반적으로 광반도체는 가시광선과 적외선, 자외선 등 빛(Photo)의 다양한 특성을 이용한 반도체를 말한다. 또한, 광반도체는 가시광선을 이용하여 다양한 색깔(Color)의 표시소자, Back Light의 광원, LED 조명 등에 사용되고 있으며, 자외선을 이용한 UV 소자, 적외선을 이용한 발광부와 수광부를 결합한 광센서 등에 활용되고 있다.

광반도체 산업은 계측기, 진단기기, 광통신 시스템 등 다양한 제품의 생산에 사용되는 부품을 제조하는 중간재 산업이며, 공정 및 재료의 특성이 성능에 직결되는 제품이므로, 자체 생산 공정을 가진 업체를 중심으로 생산되고 있으며, 다양한 분야의 제품에 활용되기 때문에 경기변동에 의한 영향이 적은 산업으로 요약할 수 있다.

IHS Markit에 따르면, 세계 광반도체 시장은 2018년 71,533백만 달러 규모이며, 이후 연평균 4.34%씩 성장하여 2025년에는 96,305백만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망된다.

[표 4] 세계 광반도체 시장 규모 및 전망 (단위 : 백만 달러)

2018년	2019년	2020년	(CAGR : 2021년~2025년)	2021년(E)	2023년(E)	2025년(E)
71,533	73,807	76,957	4.34%	80,576	88,461	96,305



*출처 : IHS Markit, 한국기업데이터(주) 재가공

■ **센서(Sensors) 시장 동향**

센서는 주변의 정보를 감지하여 전기적 신호로 변환하는 기술로 자동차, 의료기기, 로봇 산업 등 다양한 분야에 적용하여 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 앞으로 도입될 미래형 자동차, 로봇, 웨어러블(착용형) 기기 등이 제 기능을 하려면 곳곳에 센서가 장착되어야 한다.

일본 경제 전문지 닛케이 베리타스는 향후 10년 이내에 전 세계에 센서가 1조 개까지 장착되는 트릴리언(trillion) 센서 시대가 올 것으로 전망했다. 센서는 자동차, 조선 등의 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 최소의 비용으로 제품의 차별화, 고부가가치화를 시킬 수 있는 산업이다.

동사가 영위하고 있는 광센서 분야는 인간의 오감 중 시각에 해당하는 기능을 갖는 디바이스로 초기에는 자연의 빛을 감지한 것에 지나지 않았으나, 현대에는 스스로 빛을 발하여 그 빛이 측정 대상물에 반사되어 오는 파장에 따라 대상물의 움직임을 감지하는 구조로 다양화되고 있으며, 광센서는 포토다이오드, 포토트랜지스터, 포토 IC 등으로 세분화할 수 있다.

광센서(Photonic Sensors)는 빛 자체 또는 빛에 포함되는 정보를 전기신호로 변환하여 감지하는 소자를 말하며, 광전자 증폭관(PMT), 포토다이오드, 포토트랜지스터 등이 포함된다. 광센서는 빛에너지의 특성을 이용한 것으로 고감도, 높은 분해능, 고속도, 비접촉 등의 특징을 갖는다.

광센서의 활용 예를 분야별로 보면 포토다이오드는 주로 고속 광을 검출하는 데 활용되고, 포토트랜지스터는 저속 광의 검출이나 제어기기의 작동을 검출하는 데 활용되며, 포토 IC는 고속 광과 저 조도광을 검출하는 데 활용된다.

[표 5] 광센서 용도별 분류(위) 및 활용 예시(아래)

분류	종류	주요 내용
광도전 광센서	광도전 셀	카메라 노출계, 포토릴레이, 광제어, 복사기/카메라 이미지 센서
광기 전력형 광센서	포토다이오드	카메라 EE 시스템, 리모콘, 광전스위치, 바코드 리더
	포토트랜지스터	
	광사이리스터	
광전자 방출형 광센서	광전자 증배관	정밀 광계측 기기, 초고속·극미약광 검출
	광전관	
자외선 센서	Si 자외선	의료기기, 분석기기
	포토다이오드	
	UV 트론	
복합형 광센서	포토카플러	무접점 릴레이, 자 광치 노이즈컷, 광전식 카운터, 광전 스위치
	포토인터럽터	
분류	활용 예시	
포토다이오드	광섬유, 포토트랜지스터, 포토 IC, 로터리 엔코더 등 고속 광	
포토트랜지스터	무접점 스위치, 근접센서 등 저속 광의 검출, 각종 제어기기 작동 검출	
포토 IC	리모컨의 수광부, 인코더, 조도계, 포토카플러 등의 고속 광과 저 조도광	
CDS	리모컨의 노출계, 조도계 등의 광량 검출	
이미지센서	비디오, 카메라, 방범 모니터, 팩스, 암시경	

*출처 : 충북대학교 컴퓨터공학과 자료, 중소기업 로드맵, 한국기업데이터(주) 재가공

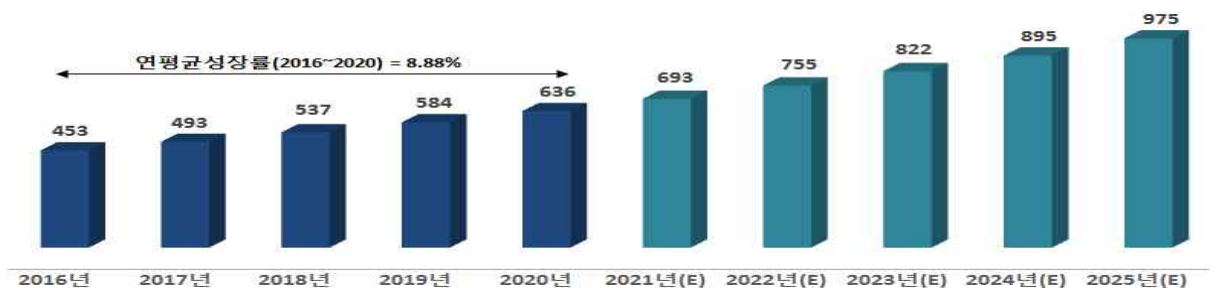
광센서 산업의 발전 없이는 미래 정보화 사회의 실현이 불가능할 정도로 그 중요성은 매우 높
 은데, 광센서 산업은 아이디어 및 기술력의 비중이 크며 원자재와 인건비 부담이 적은 지식 기
 반형 산업으로 공해 발생이 적은 환경 친화형 산업이며 타 산업과 비교하면 기술변화가 빠르다.
 또한, 기술 인력의 질과 수준이 산업경쟁력을 좌우하는 전형적인 기술집약적 산업이며, 원재료
 나 인건비의 비중이 작고, 이와 함께 정보통신산업의 핵심이자 생명기술(BT), 나노기술(NT),
 환경기술(ET) 등 미래 유망 분야와 국방, 생산가공 및 측정 등 다양한 분야의 기반을 이루고
 있으며, 인류의 복지증진과 지구환경에 기여하는 산업이다.

광센서 산업은 특히 기초기술과 고급인력을 근간으로 하는 연구개발(R&D)이 중시되는 기술집
 약적 산업이며, 고도의 정보화 및 고부가가치를 창출하는 산업이고, 타 산업과 비교하면 라이프
 사이클이 짧아 새로운 기술의 창출이 끊임없이 이루어져야 하며 단기간 내에 후발국이 선발국
 을 추월할 수 없는 산업으로 장기적인 계획과 투자가 요구된다는 특징을 갖는다.

Market Research Future에 따르면, 세계 광센서 시장은 2018년 537백만 달러 규모이며, 이
 후 8.88%씩 증가하여 2025년에는 975백만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망된다.

[표 6] 세계 광센서 시장 규모 및 전망 (단위 : 백만 달러)

2016년	2018년	2020년	(CAGR : 2021년~2025년)	2021년(E)	2023년(E)	2025년(E)
453	537	636	8.88%	693	822	975

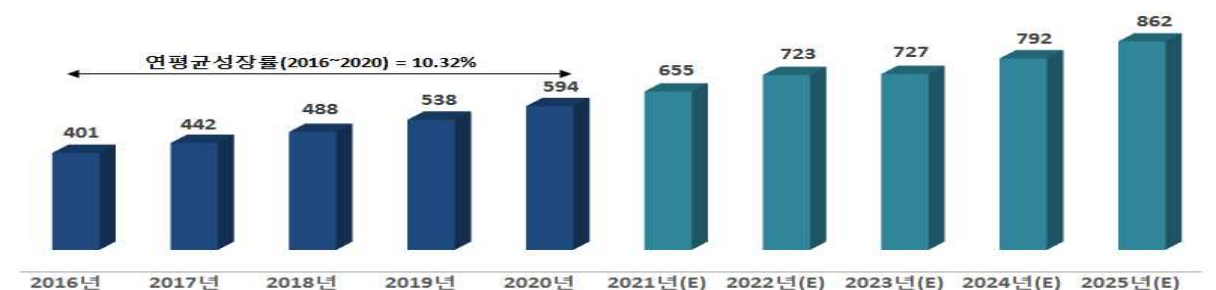


*출처 : Market Research Future, Ambient Light Sensor Market Research Report, 한국기업데이터(주) 재가공

Markets and markets에 따르면, 국내 광센서 시장은 2018년 488억 원 규모이며, 연평균
 10.32% 증가하였고, 이후 연평균 8.88%의 성장률을 보이면서 2025년에는 862억 원에 달한
 전망이며, 국내 광센서 시장은 오토닉스, 광전자 등이 참여하고 있다.

[표 7] 국내 광센서 시장 규모 및 전망 (단위 : 억 원)

2016년	2018년	2020년	(CAGR : 2021년~2025년)	2021년(E)	2023년(E)	2025년(E)
401	488	594	8.88%	655	727	862




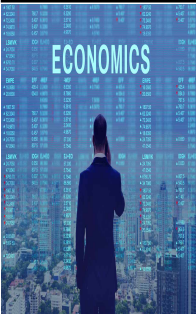


*출처 : Market sand markets, Light Sensors Market, 한국기업데이터(주) 재가공

오토닉스는 공장 자동화 전자부품(포토센서, 근접센서, 압력 센서, 제어기기), 전기기기 제조를 목적으로 1989년에 설립되었으며, 해외에서 판매된 매출이 전체 매출의 50%에 이를 정도로 해외 시장 개척에서 성과를 거두고 있는 글로벌 전문기업이다.

광전자는 트랜지스터, SMD TR, 발광소자, 리모콘 모듈, 발광 다이오드(LED), 다이오드용 웨이퍼 펌(Fab) 제조를 목적으로 1984년에 설립되었으며, 광센서 관련 제품으로는 발광소자, 수광소자, 포토인터럽터, 엔코더, 적외선 리모컨 수신 모듈, IrDA 등이 있다.

해외 광센서 시장에는 HAMAMATSU(일본)가 있으며, 영국 EMI사와 함께 아주 작은 빛에도 민감하게 반응하는 센서인 ‘광전자 증배관(PMT)’을 제조할 수 있는 몇 안 되는 기업이다.

[표 8] LED 및 광(센서) 산업 거시환경(PEST) 분석

정치/법규(Political)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정부에서 정책적으로 정보통신기술(ICT) 산업 강한 육성 의지 ▶ 정부는 창조경제 슬로건 하에 융합기술에 대한 적극적인 지원을 하고 있음 ▶ 국내 "LED 조명 2060 계획", 태양전지 등 국가적 차원의 보급정책 추진 중 ▶ 해외 자국 시장 보호를 위한 기술 규제 및 기업정책 지원
거시/미시경제(Economic)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정보통신기술(ICT) 및 첨단 융합산업의 급속한 성장으로 광 융합 신규 시장 창출 및 확대 기회 도래 ▶ 신중경제국의 건설경기 부양 및 전력난 해소, 초고속 IT 확대 등으로 시장 침투 기회 증가 ▶ 친환경 에너지 정책에 따른 고효율 조명/태양광 신재생에너지 보급 활성화 ▶ 반도체가 활용되는 스마트폰 및 융복합 시장확대 ▶ (높은 시장진입 장벽) 선도기업 독과점, 수직계열화 활성화로 경쟁력 강화
사회/문화(Social-Cultural)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 다양한 분야(IT 등)에서 대용량 정보 처리 및 대면적 표시 요구 급증 ▶ 세계 에너지 절감 정책이 본격화되면서 LED 조명 및 태양광의 공공 시장 보급 활성화 ▶ 광 융합 분야의 전문 인력 부재와 네트워크, 대기업 상생 구축의 어려움 ▶ 장비 기업들이 협력업체 발굴을 통해 신뢰성을 향상 ▶ 저가 공세(중국)와 고품질 정책(선진국) 사이의 국내 기업은 샌드위치 상태
기술/정보(Technological)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 국내 IT/자동차/조선/디스플레이 등 관련 융합 및 수요 산업과 기술이 세계적인 수준 ▶ LED, OLED 등 새로운 광원의 효율 및 제조 기술의 꾸준한 발전 및 관련 IT융합 기술의 발전 ▶ 광통신 및 광 정보기기의 광 ICT 부품 기술 확장과 센서, 렌즈 등 광소재 및 광 정밀기기 선진국과의 기술 격차 감소 추세 ▶ 글로벌 기업의 특허 공세 강화, 부품 소재 기술경쟁력 약화 우려 지속

*출처 : 한국과학기술정보연구원, 한국기업데이터(주) 재가공

Ⅲ. 기술분석

꾸준한 연구개발을 통한 기술 고도화 작업 진행

동사는 기업부설연구소를 2000년 08월부터 운영하고 있으며, 다양한 연구개발을 통해 기술경쟁력을 가진 원천기술 및 지식재산권을 확보하기 위해 노력하고 있다.

■ 광센서(Photonic Sensors) 기술

광은 입자와 파동의 성질을 함께 가진 에너지이며, 광의의 의미로는 전자기파(Electromagnetic wave)의 범주에 속한다. 핵심기술은 광학적 특성 분석 기술, 이미지 센서 기술 등이 있다.

광학적 특성 분석 기술은 광원에서 보낸 빛이 검출기에 도달할 때까지 광 손실, 위상 변화 등 광학적인 특성의 변화를 분석하는 기술로, 빛이 거쳐서 간 물질의 온도, 압력, 전기장, 자기장, 회전, 화학물질 농도 등을 감지할 수 있다. 이미지 센서 기술은 광을 감지하는 작은 픽셀들로 구성된 2차원의 행렬 구조를 가지는 소자/모듈로 CCD(Charge Coupled Device) 기술과 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 기술이 있다.

광센서는 광을 받아 전기적 신호로 전환하는 기능 소자(Transducer)이므로 수광소자라고 하며, 수광소자는 광을 검출하는 광센서를 총칭한다. 광전 효과(Photoelectric effect, 물질이 광을 흡수하여 광전자를 방출하는 현상)에 따라 광센서를 분류할 수 있다.

[표 9] 광전 효과에 의한 광센서의 분류

광전 효과(Photoelectric effect)			
광기전력 효과	광도전효과	광전자 방출 효과	초전효과
포토다이오드	CdS cell	광전자 증배관	PZT계
포토티랜지스터	CdSe cell	광전관	LiTaO ₃ 계
태양전지	PbS cell	양자형 센서	적외선 센서

*출처 : 광센서 기술 및 응용, 전자공학회지(이병철, 김상용), 한국기업데이터(주) 재가공

일반적으로 광센서에는 포토다이오드, 포토티랜지스터 등이 포함되며, 포토다이오드는 반도체 다이오드의 일종이며, 빛에너지를 전기에너지로 변환하는 소자로, P형 반도체와 N형 반도체의 접합을 이용한 P-N 포토다이오드와 접합 중간에 진성 반도체(Intrinsic Semiconductor)층을 설치하여 응답속도와 변환효율을 높인 P-I-N 포토다이오드가 있다.

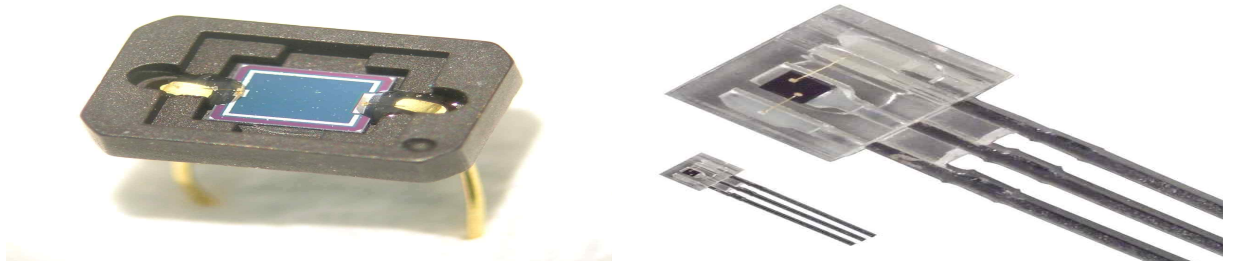
반도체의 금지 대폭(Band gap)에 따라 흡수할 수 있는 빛의 파장이 다르므로 사용되는 물질에 따라 포토다이오드의 빛 파장 범위와 그 응용 분야가 달라진다. 상용화된 포토다이오드에 일반적으로 사용되는 물질에는 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 인듐갈륨비소화물(InGaAs), 황화납(PbS) 등이 있다.

포토다이오드는 컴퓨터 단층촬영, 혈관 모니터 같은 다양한 의료장비를 비롯하여 카메라, 핸드폰, 레이저 거리측정기, 야간촬영장치, 광통신, CD 재생기, 화재경보기, 리모컨 수신부 등 많은 응용 분야에서 널리 쓰인다.

포토티랜지스터는 반도체 트랜지스터의 일종이며, 포토다이오드와 마찬가지로 빛에너지를 전기 에너지로 변환하는 소자로, 일반적으로 접합형 트랜지스터(Bipolar junction transistor)의 구조에 베이스-컬렉터 접합으로 빛이 입사된다. 또한, 빛에 의해 생성된 전류가 트랜지스터 동작으로 증폭되기 때문에 빛에 대한 감도가 높다는 장점도 있으나, 반응속도가 느린 단점도 있다.

포토티랜지스터는 발광 다이오드(LED)와 조합하여 포토커플러(Photocoupler)로 널리 사용되고 있으며, 이를 이용한 응용 분야로 측정 및 제어 시스템, 공장 자동화 제어 시스템, 정보통신 기술 및 정보처리기술, 보안시스템, 컴퓨터의 주변기기, 놀이기기, 자동판매기, 고체릴레이, 전원 제어 등이 있다.

[그림 1] 포토다이오드(왼쪽) 및 포토티랜지스터(오른쪽) 구조



*출처 : ko.wikipedia.org/wiki(왼쪽), www.digikey.com(오른쪽), 한국기업데이터(주) 재가공

최근 거울상 구조를 지닌 초분자 카이랄성(Chirality) 소재를 활용하여 두 종류로 나누는 원편광을 선택적으로 감지해 전기적 신호로 변환할 수 있는 신개념 광통신용 원편광 광센서가 개발되었다. 광통신용 원편광 광센서는 들어오는 빛의 세기를 두 배 이상 향상할 수 있어 별도의 기구 없이도 광신호를 암호화할 수 있어 네트워크 보안이 강화될 전망이다.

광센서에 들어오는 빛을 손실 없이 활용, 더 높은 감도로 원편광을 구분할 수 있어 별도의 광학 기구가 필요 없이 광신호 암호화가 가능하여 향후 기술 상용화를 앞당길 것으로 예상되며, 혈관과 같은 시료를 관찰할 수 있는 편광 이미징은 물론, 이미지 센서, 광 스캐너 등의 기술은 보건/의료 및 실생활에도 응용할 수 있을 것으로 전망된다.

■ 우수한 전문 인력 및 꾸준한 연구개발을 통한 기술경쟁력 확보

동사는 한국산업기술진흥협회에서 인정한 기업부설 연구소를 2000년 08월부터 운영하고 있으며, 높은 기술력을 바탕으로 기존제품 기술 개선 프로젝트, 새로운 시장선도 기술 프로젝트 등을 핵심과제로 선정, 내부 R&D 프로그램을 통해 수행하고 있다.

[표 10] 연구개발투자비용 (단위 : 백만 원, %)

과목	2020년 3분기	2019년	2018년
연구개발비용 계	2,123	2,663	2,758
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]	7.9	7.1	6.6

*출처 : 동사 분기 보고서(2020년 09월), 사업보고서(2019년)

동사는 연구개발의 투자를 위해 2020년 11월 기준 24명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 기존제품의 성능향상을 위해 연구하며, 신제품의 개발을 위해 연구개발 활동을 진행하고 있다.

또한, 동사는 꾸준한 연구개발 투자를 통해 수요자의 다양한 요구사항에 따른 커스터마이징 (Customizing) 기술을 확보하고 있으며, 이를 통해 고객사의 요구에 유연한 대처가 가능하며, 제품 라인업이 다양하여 특정 제품에 대한 의존도가 낮아 매출 변동성 위험이 낮은 편이다.

동사는 연구소를 중심으로 제품 설계, 개발 등을 주도적으로 수행하여 최근 5년간 연구개발실적 20건을 보유하고 있으며, 개발인력 개개인의 전문분야를 기반으로 각각 업무 분담을 함으로써 전문적이고 효율적인 기술 개발 활동을 수행하고 있다.

[표 11] 최근 5년간 연구개발실적

구분	연구개발실적	구분	연구개발실적
01	포토디바이스 개발	04	SP O ₂ 센서
	▶ X-Ray용 포토 칩 Array	05	UV 센서
	▶ Sub-Mount 일체형 포토 칩	06	스크린 도어 센서
	▶ UV 센싱용 포토 칩	07	차량감지장치
	▶ IrDA용 포토다이오드 칩	08	LDM 모듈(실내용)
	▶ Color 센서용 포토다이오드 칩	09	집광형 태양광 추적 센서 및 슬라셀모듈
	▶ 범용 포토다이오드 칩	10	엘리베이터 센서
	▶ ESD 방지용 Zener 다이오드 칩	11	방산용 레이저 디텍터
02	레이저 프린터용 포토다이오드	12	Sun load 센서
03	하이패스(Hi-Pass)(ETCS)	13	프로젝터용 LED

*출처 : 동사 분기 보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

▶ X-Ray용 포토 칩 Array

동사는 영상을 보기 위해 필름을 사용하던 기존 방식 대신 의료용 CT의 이미지 센서를 이용해서 영상을 볼 수 있는 포토다이오드 Array를 개발하였으며, 이를 통해 고에너지의 대형 화물 검색용 X-ray Application 및 휴대용 화물을 검색할 수 있으며, 향후 CT 국산화로 수입 대체 효과와 함께 국산화된 X-ray 대형 컨테이너 검색 시스템을 국내 항만에 설치하여 밀수를 사전에 차단할 수 있을 것으로 기대된다.

▶ Sub-Mount 일체형 포토 칩

동사는 레이저 다이오드(LD) 조립 공정에 Heat Sink용 Sub-Mount와 모니터용 포토다이오드가 사용되어 각각의 디바이스를 1개로 만들어 조립 공정의 효율증대와 개별 디바이스를 사용해 발생하는 위치 산포를 줄여 LD 제품의 특성을 향상시킬 수 있는 기술을 개발하였으며, 이를 통해 LD 조립성 향상 및 모니터링 현황 산포 개선으로 원가 절감 및 품질개선을 기대할 수 있다.

▶ UV 센싱용 포토 칩 및 IrDA용 포토다이오드 칩

동사는 UV 파장의 광원을 검출할 수 있는 UV 센싱용 포토다이오드 칩을 개발하였으며, 이를 통해 일본 및 미국에서 수입되던 제품에 대해 수입대체 효과가 있을 것으로 기대된다. 또한, 동사는 IrDA 통신용에 사용하는 고속 편 포토다이오드를 개발하여 IrDA ver 1.1에 적용하고 있으며, 이를 통해 모바일 기기의 데이터 통신용 소자에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

▶ Color 센서용 포토다이오드 칩

동사는 고속 핀 포토다이오드 칩 자체에 필터 기능을 내장하여 특정 파장의 광원만을 검출하는 구조의 포토다이오드에 필터링 기술을 적용한 칩을 개발하였으며, 이를 통해 소자 패키지 공정에서 외부의 필터를 사용하지 않음에 조립 공정의 자유도를 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다.

▶ 범용 포토다이오드 칩

동사는 범용 포토다이오드 제조 프로세스를 확립하여 저 누설(Low Leakage) 포토다이오드 프로세스를 개발하였고, 이를 통해 범용 포토다이오드는 전량 수입에 의존했으나, 국내 개발 및 생산하여 기존 수입 물량을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

▶ ESD 방지용 Zener 다이오드 칩

기존의 백색 LED 및 Green LED는 정전기에 취약해 소자가 정전기로 파괴된다는 문제점이 존재하였으나, 동사는 이러한 문제점을 개선하기 위해 LED 소자의 ESD에 의한 소자 파괴를 막기 위해 사용되는 Zener 다이오드 칩을 개발하였다. 현재 LED 제조 업체에서 정전기 보호를 위해 제품 대부분에 Zener 다이오드를 사용함에 따라 수요가 급증할 것으로 기대된다.

▶ 조명용 LED Sub-Mount 칩

조명용으로 LED 사용이 늘어남에 따라 열 방출이 중요한 문제로 부상하게 되었고, 열전도도가 높은 Sub-Mount 칩의 필요성이 대두되고 있다. 이에 동사는 열전도가 200W/m.K 이상 기판을 적용한 열전도도가 높은 Sub-Mount 칩을 개발하였으며, 향후 수요 증대가 기대된다.

[표 12] 주요 지식재산권 보유 현황

구분	등록(공개)번호	발명의 명칭
특허권	10-2111536	수화물 정렬감지가 가능한 물류 이송 로봇
	10-2077692	광산란 기반의 먼지 센서
	10-2076307	4분할 일사 센서
	10-2038520	방수형 광센서 패키지구조
	10-1780732	엘리베이터 멀티 빔 센서를 이용한 모니터링방법
	10-1750419	차량용 통합 센서
	10-2018-0046161	광검출 소자 및 그 제조방법
	10-2020-0081558	양자점 제조장치 및 이를 이용한 양자점 제조방법

*출처 : 특허청, 한국기업데이터(주) 재가공

동사는 꾸준한 기술 개발을 통해 반도체 설계기술, 공정기술, 패키지기술 및 시스템 기술, 생산 장비 제조 기술 등을 보유하여 제품개발에서 생산까지 Total Solution 시스템을 갖추고 있으며, KC 인증, 벤처기업, 이노비즈, ISO 등의 다양한 인증을 보유하고 있고, 2021년 1월 기준 특허 30건(공개 2건, 등록 28건), 디자인 8건, 상표권 2건의 지식재산권을 보유하고 있다.

동사는 사업 초기부터 지식재산권의 중요성을 인지하여 연구개발을 통해 얻은 결과에 대해서는 지식재산권으로 등록하여 관리함으로써 모방 방어를 위한 법적 보호 장치를 마련하였고, 동사가 보유하고 있는 지식재산권은 동사의 제품과 직접 연관된 지식재산권으로 제품에 관해 명확히 보호하고 있으며, 동사의 제품을 모방하려는 경쟁사에 기술 장벽으로 작용하고 있다.

IV. 재무분석

최근 3개년 매출감소세 불구, 재무안정성과 현금창출능력 우수

동사 최근 3개년 매출감소세 및 수익성 하락세 이어지고 있으나, 부채비율과 자기자본비율의 적절한 관리 및 유동비율과 잉여금의 증가로 전체적인 재무안정성이 우수한 수준을 보인다.

■ 최근 2개년 수익성 하락하였으나, 매우 안정적인 재무구조 유지 중

동사는 반도체 제조 공정(FAB)을 바탕으로 비메모리 반도체 칩과 센서 및 센서 모듈, 시스템의 수직계열화 제품, LED 응용제품 등을 주력 생산하여 판매 중인 코스닥 상장 기업으로, 반도체 설계기술, 공정기술, 패키징기술 및 시스템 기술, 생산 장비 제조 기술 등을 보유하여 제품 개발에서 생산까지 토탈 솔루션 시스템을 갖추고 있으나 동사 주요 제품군 중 레이저프린터용 COB, 소자 등의 판매량이 감소하면서 최근 3개년 매출 감소가 지속되고 있다.

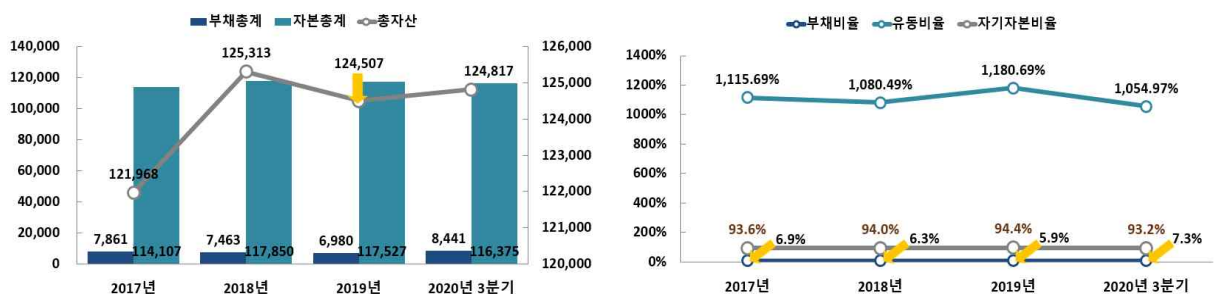
수익성 측면에서, 최근 3개년(2017년~2019년) 영업이익률이 8.72%, 2.41%, 2.88%로, 매출 감소에 따른 고정비부담 증가, 원가 상승 등으로 인해 영업이익률이 최근 2개년 연속 2%대에 머물고 있으나 2019년도 판매비 절감 등을 통해 2019년 영업이익(1,199백만 원)이 전년(1,094백만 원) 대비 소폭 증가하였고, 영업외수지 개선(기타수익과 금융수익 외)을 통해 당기 순이익률은 5.14%, 당기순이익은 2,139백만 원을 시현하였는바, 영업이익률 대비 순이익률은 비교적 양호한 흐름을 보이고 있다.

재무안정성 측면에서 동사의 최근 3개년 및 2020년 3분기 부채비율은 2017년 6.89%, 2018년 6.33%, 2019년 5.94%, 2020년 3분기 말 7.25%이며, 최근 3개년 및 2020년 3분기 자기자본비율은 2017년 93.56%, 2018년 94.05%, 2019년 94.39%, 2020년 3분기 말 93.24%로, 부채비율이 10% 미만을 유지하고 있는 가운데 자기자본비율은 90%를 상회하면서 매우 안정적인 재무구조를 견지하고 있다.

또한, 2019년 말 및 2020년 3분기 말 유동비율이 각각 1,180.71%, 1,054.69%에 달하고, 유동금융자산의 증가 및 자본충실도(잉여금 누적) 제고 추세와 더불어 2020년 3분기 사업보고서상 연구개발 활동 외에는 설비 신설 및 대규모 자금이 소요되는 투자계획이 없는 점 등을 감안할 때 중기적으로 안정적인 재무구조 유지 가능 시 된다.

[그림 2] 요약 재무상태표 분석

(단위 : 백만 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 매출감소세 및 영업이익률 미흡, 순이익률은 양호

동사의 최근 3개년 매출액은 2017년 48,983백만 원, 2018년 45,226백만 원, 2019년 41,649백만 원으로 3년간 매출감소세가 지속되고 있고, 이에 따른 고정비부담 증가와 원가 상승 등으로 인해 수익성도 저하되어 2019년도 영업이익률과 당기순이익률이 2.88%, 5.14%로, 전년 대비 영업이익률은 0.47%p 증가, 당기순이익률은 2.51%p 감소하였다.

또한, 2017년도의 영업이익률(8.72%)에 비해 영업 수익성이 현저히 저하되었고, 당기순이익 감소 추세 이어지고 있으나 영업외수지 개선(기타수익과 금융수익 외)을 통해 2019년도 당기순이익률은 5%를 상회하고 있다. 동사 주요 제품군 중 반도체 칩 품목의 매출실적은 꾸준하나, 레이저 프린터용 COB, 소자 등의 매출실적 감소 폭이 상대적으로 확대되면서 최근 3개년 매출 감소가 지속되고 있는 것으로 분석된다.

[그림 3] 요약 포괄손익계산서 분석

(단위 : 백만 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 2020년 3분기 순이익 전년 동기 대비 크게 감소하였으나, 성장 여력 보유

2020년 3분기 누적 매출액은 30,012백만 원으로, 전년 동기(31,060백만 원) 대비 0.16% 감소하였으나 주요 원재료(반도체 Wafer, 센서 Cap 등) 가격 하락에 따른 매출원가 감소 등으로 인해 2020년 3분기 말 영업이익률(3.16%)이 전년 동기(2.90%) 대비 0.26%p 상승하였다.

한편, 영업외수지 부문에서 기타수익의 증가에도 불구하고 관계기업 투자손실로 인해 2020년 3분기 말 당기순이익률(1.81%)은 전년 동기(8.21%) 대비 크게 하락하였고(-6.40%p), 당기순이익(559백만 원)도 전년 동기(2,547백만 원) 대비 1,988백만 원 감소하였다.

동사의 주요 제품군 중 반도체 칩 품목의 매출실적은 꾸준하나 레이저 프린터용 COB, 소자 등의 매출실적 감소 폭이 상대적으로 확대되면서 2017년도부터 지속된 매출감소세가 2020년 3분기까지 이어지고 있고, 코로나19 장기화로 인해 국내외 경기가 동반 위축되고 있다.

다만, 동사가 반도체 설계기술, 공정기술, 패키지기술 및 시스템 기술, 생산 장비 제조 기술 등을 보유하여 제품개발에서 생산까지 토털 솔루션 시스템을 갖추고 있고, 삼성전자, 엘지이노텍, 서울반도체, 루멘스 등을 주요 매출처로 확보하여 매출채권 안정성 확보하고 있으며 제품 라인업을 다양화함으로써 경기변동의 위험에 대처할 수 있는 제품구조를 구축하고 있다.

이와 더불어 동사가 영업 네트워크를 강화(해외 판매망 정비, 온라인 마케팅)하고, 가격경쟁력 강화를 통해 시장지배력을 높이고 있으며, 수주에서 납품까지 Cycle 단축을 통해 고객 대응력을 강화하는 점 등을 고려할 때 향후 외형 회복 및 수익성 개선 가능성 있을 것으로 예상된다.

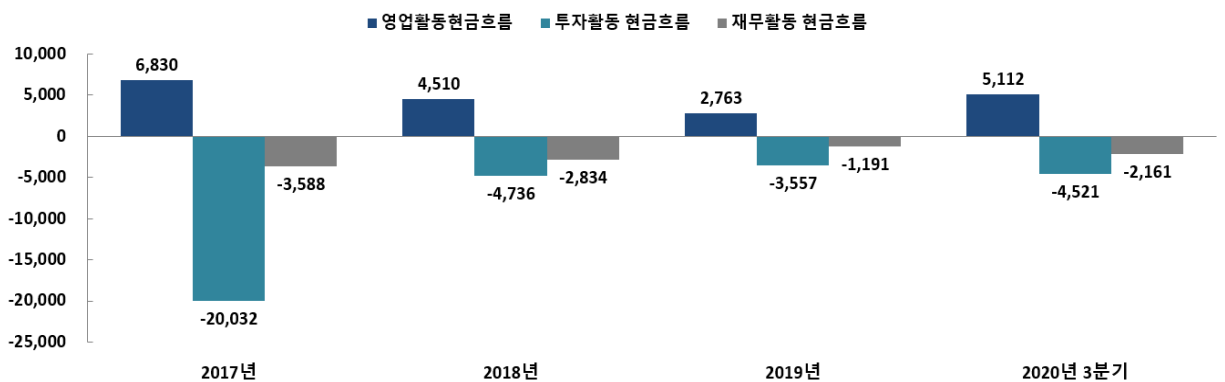
■ **영업활동을 바탕으로 한 우수한 현금창출능력 보유**

2019년 동사의 영업활동현금흐름(2,763백만 원)은 영업이익(1,199백만 원)을 크게 상회하고 있고, 영업창출현금으로 단기금융상품 취득, 대여금 증가 등의 투자활동 현금유출(투자활동현금흐름 -3,557백만 원)과 배당금 지급, 리스부채 상환 등의 재무활동 현금유출(재무활동현금흐름 -1,191백만 원)이 발생하였는바, 영업활동현금흐름 유입 대비 투자활동 및 재무활동 현금유출이 상대적으로 증가하면서 2019년 말 현금성 자산은 전년 말 대비 1,885백만 원 감소하였다.

한편, 영업에서 창출된 현금흐름이 큰 폭으로 증가하면서 2020년 3분기 말 영업활동현금흐름(5,112백만 원)이 전년 동기(1,679백만 원) 대비 크게 증가하였고, 대규모 단기금융상품의 취득 등의 투자활동 현금유출(투자활동현금흐름 -4,521백만 원)과 배당금 지급, 자기주식 취득, 금융리스부채 지급 등의 재무활동 현금유출(재무활동현금흐름 -2,161백만 원)이 발생했다.

이로 인해 2020년 3분기 말 현금성 자산(12,313백만 원)이 2019년 말(13,896백만 원) 대비 1,583백만 원 감소하였기는 하나 안정적인 영업활동을 바탕으로 투자활동과 재무활동이 균형을 이루고 있어 우수한 현금창출능력을 보유하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 4] 현금흐름 분석 (단위 : 백만 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2020년 09월), 한국기업데이터(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

사업 다각화 및 신제품 개발 전략

동사는 축적된 기술을 활용하여 획기적인 신구제품을 개발 출시함으로써 제품가격의 하락을 방지하며 고품질 정책으로 시장을 지배하는 전략과 사업을 다각화하려는 전략을 수립하고 있다.

■ 향후 추진하려는 신규 사업

동사가 추진하는 향후 신규 사업은 센서 부분의 경우, 고신뢰도/고부가가치의 자동차 전장용 광 센서 부품, 방산용 센서, 센서 패키지 사업 그리고 바이오 헬스케어(바이오센서) 사업 부문으로 사업 분야를 확장할 계획이다. 반도체 부분의 경우, 동사는 고성능을 필요로 하는 제품을 중심으로 빠른 성장세를 보이는 플립칩(Flip chip) 패키지에 적용할 수 있는 증착 방식(도금방식)과 식각(Etching) 기술을 활용하여 고부가가치의 제품을 개발하여 고객에게 판매할 계획이다.

추가로 기존의 BLU(Back Light Unit)에 주로 판매되었던 Zener 다이오드 부분을 시장 규모가 큰 조명용 Zener 다이오드의 특성 개발을 지속 추진하고 있다.

■ 시장을 선도하기 위한 신제품 개발 전략

후발 경쟁업체의 출현으로 Zener 다이오드 칩 제품을 비롯하여 여타 제품군들의 가격이 하락하는 경향이 있으나, 동사는 고출력 발광 다이오드 제작을 위한 Zener와 Sub-Mount 기능을 겸비한 복합기능 Sub-Mount를 개발하여 후발 경쟁업체보다 우월한 품질을 유지하여 시장을 지속적으로 주도하기 위한 전략을 수립하고 있다.

복합기능을 겸비한 Sub-Mount는 향후 주목받을 것으로 예측되는 조명시장에서 집중적으로 수요가 발생할 것으로 예상된다(조명용 LED는 고전력용 LED가 필요함). 고전력용 LED에는 많은 양의 열이 발생하는데 이때 Surge와 열을 방열시켜 줄 Zener와 Sub-Mount를 필요하다.

Zener와 Sub-Mount를 동시에 LED에 장착하기에는 제품의 크기가 커지므로 적용에 어려움이 있었으나, 동사가 이번에 개발한 일체형 Sub-Mount는 이러한 요구사항을 획기적으로 해결한 제품이다. Zener 제품뿐만 아니라 매년 새로운 제품을 출시하여(예 : Power Transistor, 하이패스(High Pass)용 OBU, Color 센서 등) 시장을 선도하는 전략을 펴고 있다.

[표 13] 주요 신제품 현황

구분	Zener 다이오드	Sub-Mount	Power Transistor
제품			
용도	BLU, 조명용 LED 패키지	고출력 LED 패키지	Ballast, 전원공급장치

*출처 : 동사 홈페이지(<http://www.od-tech.com/>), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 기후변화에 따른 위기 및 기회대응에 대처하기 위한 전략

동사는 기후변화에 따른 위기 대응 및 기회 발굴을 위해 온실가스 감축 및 관리를 전사 차원의 주요 경영 이슈로 다루고 있다. 기후변화에 따른 위기대응 차원에서 제품 전 과정 CO₂ 배출량 정보관리, 온실가스 에너지 목표 관리제 대응 등에 중점을 두고 있다. 특히, 태양전지사업과 LED 조명은 지속 투자 확대를 추진하고 있다.

동사는 저탄소 녹색성장 기본법(제42조 제5항 및 시행령 제 29조)에 따른 관리업체에 해당하지는 않지만 지속하여 온실가스 배출량 및 에너지사용량을 관리하고 있으며, 2005년 4월부터 ISO 14001을 취득하고 유지 활동을 하고 있다.

동사는 전 세계에 출시하는 제품에 대해 EU의 RoHS 기준에 충족할 수 있는 제품으로 점진적으로 대체를 해나가고 있으며, 제품 설계 단계부터 재활용 가능 비율을 높일 수 있도록 지속적인 연구개발을 투자를 진행하여 녹색 경영기업으로 성장하기 위해 노력하고 있다.

[그림 5] 동사의 품질경영



*출처 : 동사 홈페이지(<http://www.od-tech.com/>), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
없음	-	-	-
최근 1년 내 증권사 투자의견 없음			

■ 시장정보(주가 및 거래량)

[그림 6] 동사 3개년 주가 변동 현황



*출처 : 네이버 금융(2021년 01월 18일)